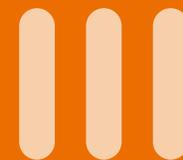




中国芯片半导体 投融资数据分析报告

2022年6月



目录

CONTENT

- ||| 芯片半导体产业基本概况
- ||| 中国芯片半导体公司创业情况分析
- ||| 中国芯片半导体行业投融资情况分析
- ||| 中国芯片半导体公司上市情况分析



||| PART ONE ||||

芯片半导体产业基本概况



相互关系

半导体主要由集成电路，光电器件，分立器件，传感器四个部分组成，但是由于集成电路占了器件市场80%以上的份额，因此**通常将半导体和集成电路等价**；当然，半导体还包括电阻电容以及二极管等元器件。

集成电路按照产品种类主要分为微处理器，存储器，逻辑器件，模拟器件四大类。在日常工作学习中，这些通常我们都**统称为芯片**。
从制作流程上来讲，一个集成电路从设计到流片出来后就成了芯片，再对其进行封装，方便应用在各个行业中。

基本定义

芯片

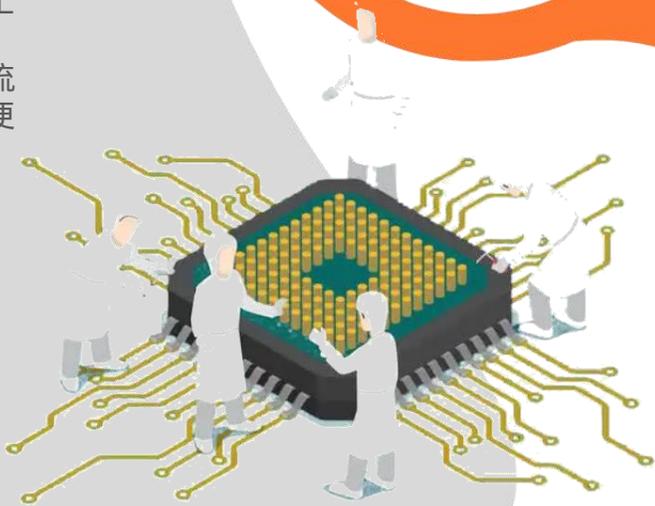
芯片，又称微电路、微芯片、集成电路，是指内含集成电路的硅片，体积很小，常常是计算机或其他电子设备的一部分。芯片是半导体元件产品的统称，是集成电路的载体，由晶圆分割而成。

半导体

半导体，指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制，范围可从绝缘体至导体之间的材料。

集成电路

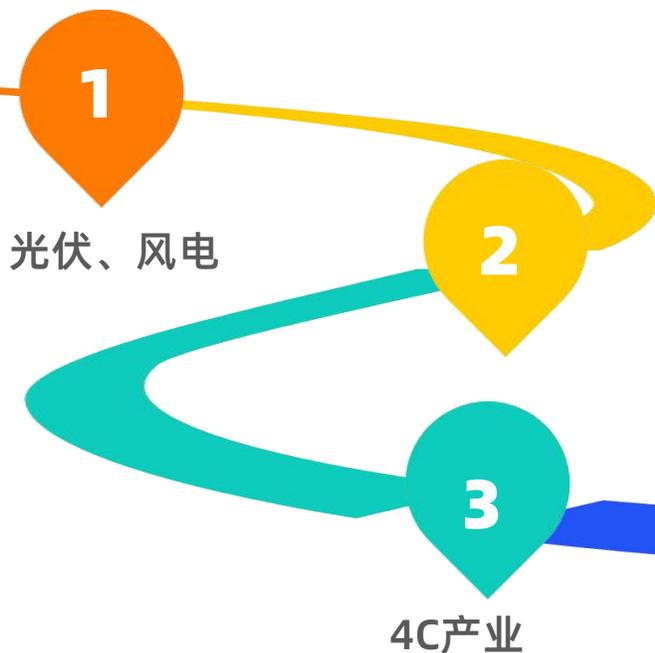
集成电路是一种微型电子器件或部件，是由半导体材料制成的一个超大规模电路的一个集合，让电容，晶体管，电阻等器件工作在硅片（或者其他介质）上。它在电路中用字母“IC”（integrated circuit）表示。



芯片半导体主要应用领域

随着5G、人工智能、智能网联汽车等新兴技术应用的兴起，新场景、新技术催生的“芯”需求势不可挡

以光伏和风电为代表的新能源发电的装机量大幅增长，太阳能发电中 DC-DC 直流转换器和光伏逆变器均需要用到 IGBT 作为功率开关。其中逆变器的效率很大程度上取决于设计使用的元器件，元器件的性能可以由功率损耗来衡量，功率损耗分为导通损耗和开关损耗。在双碳政策下，光伏、风电新能源领域对功率半导体的需求激增。



信息通讯设备

通信领域包括通信基础设施和通信终端,其中基础设施包括接入网(有线/无线)、传输网和数据中心等,一套完整的通信系统包含了从信号链到电源管理的多种模拟芯片。随着我国在5G 通讯领域进行新基站的建设,以及卫星通信、各种雷达和新型通讯设备的出现,对芯片半导体的需求也会增多。

国内各主要IT产品仍将保持旺盛的市场需求,笔记本电脑、显示器、打印机、电视机、组合音响、激光视盘机等传统产品以及新兴汽车电子均将在未来保持平稳增长。随着空调、节能电机等电子产品产能向大陆转移,功率半导体的需求也将成倍地增加。

汽车交通

汽车交通是电源芯片的重要应用领域之一。随着汽车电子化程度越来越高,汽车搭载的电子产品也越来越多,所需的芯片半导体也就越多。有专业机构进行过测算,平均每辆新能源车,需搭载搭载半导体数量约为1600个,从应用的角度来看,汽车上的整车控制器、自动驾驶域控制器,都离不开各式各样的芯片。

2022年世界主要国家/地区对芯片半导体行业的政策

● 美国

2022年2月4日众议院通过《2022美国竞争法案》（包含《半导体生产促进机制法案CHIPS》）《促进美国半导体生产法案》一系列政策：在未来5年对美国半导体产业的资金支持规模将达到520亿美元，高科技产品的供应链投资预计为450亿美元，补贴完全来自于美国政府财政预算。政府资金计划主要由美国国家科学基金会（NSF）、美国商务部（DOC）、美国能源部(DOE)等部门实施。



● 欧盟

2022年2月8日，欧盟提出了《欧洲芯片法案》一揽子计划，预计投资430亿欧元（490亿美元）。目标是到2030年，欧盟计划将在全球芯片生产的份额从目前的10%增加到20%。《芯片法案》包括一项“欧盟芯片倡议”，将汇集欧盟及其成员国和第三国的相关资源，并建立确保供应安全的芯片基金。该法案条款还包括监测欧盟产芯片出口机制，可在危机时期控制芯片出口；强调加强欧盟在芯片领域的研发能力，允许国家支持建设芯片生产设施，支持小型初创企业。

● 韩国

2022年6月，韩国政府宣布了一项五年计划，将在半导体芯片研发上投入总计1.02万亿韩元（约合7.9亿美元），以保持其在全球芯片市场的竞争优势。根据支出计划，政府承诺从2023年开始鼓励韩国在数据中心、人工智能服务和智慧城市基础设施中使用国产人工智能芯片。此外，政府希望在韩国国内培养约7,000名芯片专家，并培养更强大的产学合作，包括设计集成电路的晶圆厂公司。



● 日本

日本政府在2022年2月25日的内阁会议上通过了经济安全保障推进法案，将寻求授权对半导体、蓄电池、稀土元素和其他重要产品的供应链进行全面审查，以缓解对外国的依赖。日本政府力争在本届国会尽早通过法案。在技术开发方面，法案提出设立产官学合作组织“官民协议会”。未来将活用5000亿日元（约合人民币273亿元）规模的经济安全基金，由调查海外科学技术动向的政府相关智库在信息方面提供支持。



近年中国出台的**有关芯片半导体行业政策**



政策鼓励国内芯片半导体行业整体发展，打破国外垄断，增强科技竞争力

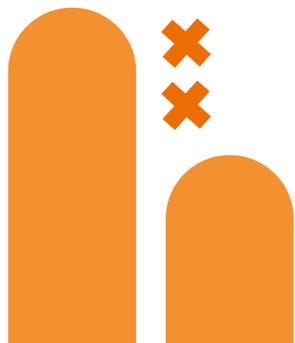
近年中国出台的**有关芯片半导体行业的政策**

发布时间	发布主体	政策名称	相关内容
2020.07	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高策》	分别从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等多个方面推动 集成电路 发展，优化集成电路产业和软件产质量发展的若干政业发展环境，深化产业国际合作
2021.1	国务院	《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》	为促进知识产权高质量创造，要健全高质量创造支持政策，加强人工智能、量子信息、 集成电路 、基础软件等领域自主知识产权创造和储备
2021.11	工信部	《“十四五”信息通信行业发展规划》	要完善数字化服务应用产业生态，加强产业链协同创新。丰富 5G芯片 、终端、模组、网关等产品种类。加快推动面向行业的5G芯片、模组、终端、网关等产品研发和产业化进程，推动芯片企业丰富产品体系，加快模组分级分类研发，优化模组环境适应性，持续降低功耗及成本，增强原始创新能力和产业基础支撑能力
2021.12	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	在“数字技术创新突破工程”方面，提出要抢先布局前沿技术融合创新，推进前沿学科和交叉研究平台建设，重点布局下一代移动通信技术、量子信息、第三代 半导体 等新兴技术，推动信息、生物、材料、能源等领域技术融合和群体性突破
2022.03	发改委、工信部、财政部、海关总署、税务总局	《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	重点 集成电路设计领域 ：高性能处理器和FPGA芯片；存储芯片；智能传感器；工业、通信、汽车和安全芯片；EDA、IP和设计服务。如业务围涉及多个领域，仅选择其中一个领域进行申请。选择领域的销售（营业）收入占本企业集成电路设计销售（营业）收入的比例不低于50%



||| PART TWO ||||

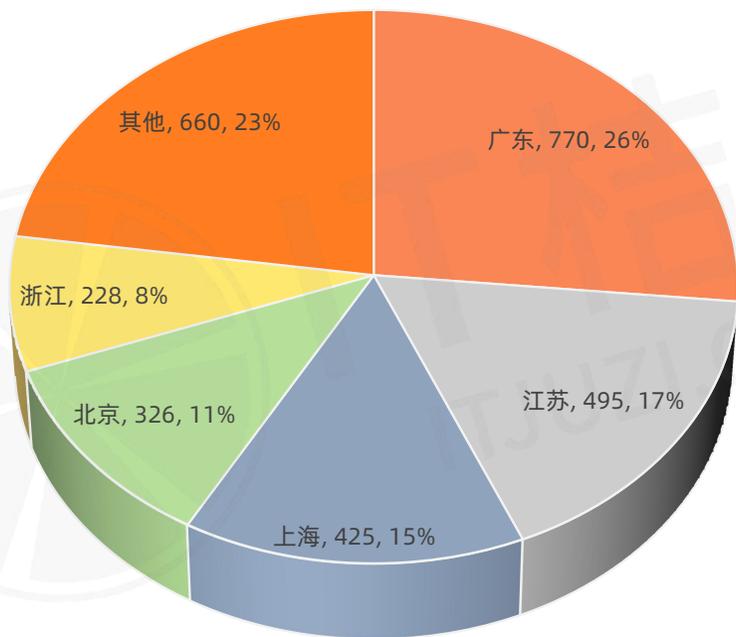
中国芯片半导体创业情况分析



中国芯片半导体公司总量分布最多的地区

广东、江苏、上海、北京、浙江成为中国芯片半导体公司总量分布最多的TOP 5地区

芯片半导体公司总量分布最多的地区



■ 广东 ■ 江苏 ■ 上海 ■ 北京 ■ 浙江 ■ 其他

截止日期：2022年6月30日 数据来源：IT桔子 © itjuzi.com

IT桔子收录到的数据显示，截止到2022年6月30日，中国芯片半导体公司总量分布最多的TOP 5地区分别是：

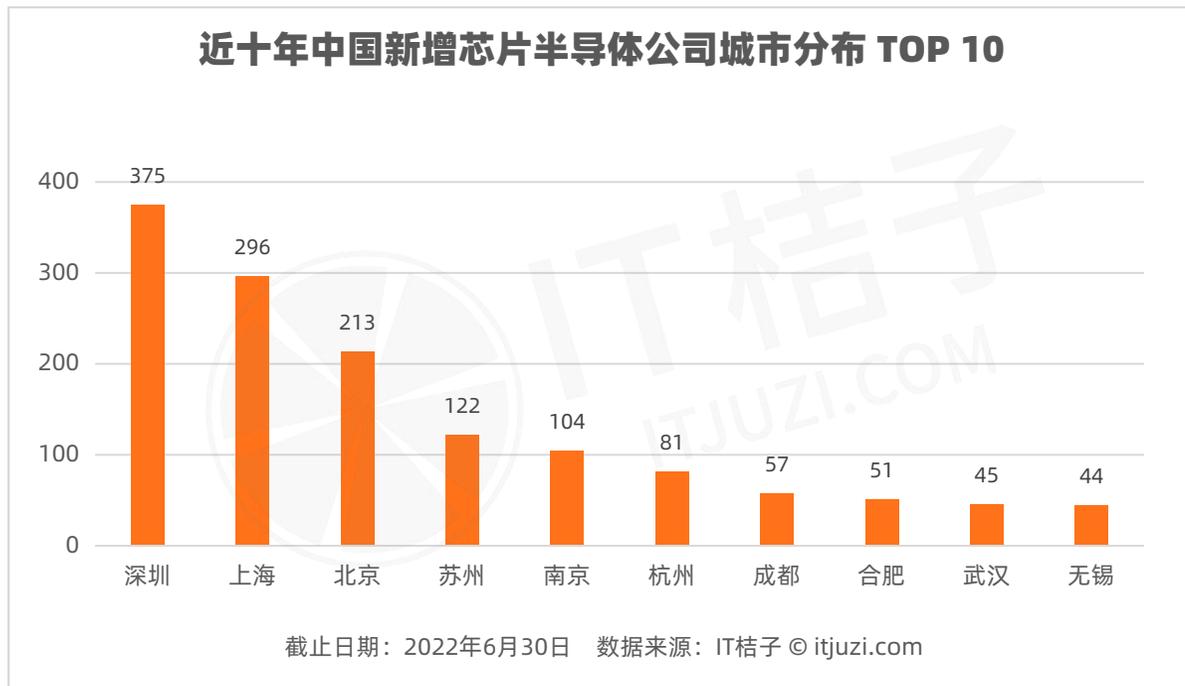
- 广东，有770家芯片半导体公司在此创立，占全国总量的26%；
- 江苏，有495家芯片半导体公司，占全国总量的17%；
- 上海，有425家芯片半导体公司，占全国总量的15%；
- 北京，有326家芯片半导体公司，占全国总量的11%；
- 浙江，有228家芯片半导体公司，占全国总量的8%。

这5个地区的芯片公司数量，占据全国总量的77%。

广东地区除深圳外，广州和珠海这两座城市在同样在凭借地理位置、政策支持和过往科技产业制造经验也吸引到大量公司在此创立，因此广东地区成中国芯片半导体公司总量最多的地区。广东地区代表性的芯片半导体公司有：峰昭科技、力合微电子、芯朋微、三安光电、汇顶科技等超20家**上市公司**；比亚迪半导体、云豹智能、艾派克微电子、粤芯半导体等多家**独角兽公司**。

近10年中国新增芯片半导体公司所在城市分布

北上深一线城市成为新增创业公司的首选



深圳代表公司：



比亚迪
半导体



上海代表公司：



北京代表公司：



苏州代表公司：



南京代表公司：



芯通科技



近十年（2011-2022H1）中国新增芯片半导体创业公司**共计1917家**，主要聚集在以深圳、上海、北京为代表的一线城市和以苏州、南京、杭州等为代表的新一线城市。

其中，**深圳**成为芯片半导体创业公司的首选。事实上，广东是中国信息产业第一大省，在消费电子、通信、人工智能、汽车电子等领域拥有国内最大的半导体及集成电路应用市场，集成电路需求超过全国的30%，再加上深圳地区政策方面的支持，因此深圳吸引到众多芯片半导体公司在此设立。

中国芯片半导体博士创业公司

超过110个博士加入到芯片半导体的创业浪潮中

中国芯片半导体公司中的博士创业人才（部分一）

姓名	人物	职位	博士毕业院校	所在公司	公司简介
黄畅		联合创始人&CTO	清华大学	 地平线 Horizon Robotics	边缘人工智能芯片及解决方案商
陈天石		创始人&CEO	中国科学技术大学	 寒武纪 Cambricon	深度学习专用的智能芯片
吴强		创始人&CEO	美国普林斯顿大学	 后摩智能 HOUMO.AI	原创新型智能计算芯片研发商
刘峻诚		创始人&CEO	加州大学洛杉矶分校	 耐能 Kneron	专注于高速低功耗的AI SoC芯片研发
沈亦晨		CEO	麻省理工学院	 曦智科技 LIGHTELLIGENCE	人工智能光子芯片研发服务商
杨清华	-	董事长	中国科学院	 昂瑞微 OnMicro	集成电路芯片研发商

中国芯片半导体博士创业公司



超过110个博士加入到芯片半导体的创业浪潮中

芯片半导体公司中的博士创业人才（部分二）

姓名	人物	职位	博士毕业院校	所在公司	公司简介
胡颖哲		创始人&CEO	普林斯顿大学		人机交互领域核心芯片和解决方案提供商
陈晓迟		联合创始人	斯坦福大学		VCSEL芯片研发商
姜黎		董事长	东京工业大学		人工智能芯片设计及配套智能算法引擎开发
鲁勇		CEO	清华大学		嵌入式人工智能技术研发商
宋子健	-	CTO	北京航空航天大学	经平电子科技	AI体感运动芯片研发商
黄伟冰	-	首席科学家	巴黎第六大学		商业视觉智能芯片及平台提供商

中国芯片半导体领域博士创业代表人物



陈天石
寒武纪
创始人&CEO

学习经历: 2005年毕业于中国科学技术大学少年班，获理学学士学位（数学与应用数学专业）；2010年毕业于中国科学技术大学计算机学院，获工学博士学位。

职业经历: 曾在中国科学院计算技术研究所工作，历任助理研究员、副研究员和研究员（教授）。

发表论文: 在IEEE/ACM Transactions、ASPLOS、ISCA、MICRO、HPCA、IJCAI、AAAI、SPAA、DATE等重要期刊和会议上发表论文50余篇。



沈亦晨
曦智科技
创始人&CEO

学习经历: 2016年毕业于麻省理工学院，获得博士学位。

职业经历: 2017年，沈亦晨创办曦智科技公司，并担任CEO，该公司成功开发出世界第一款光子芯片原型板（Prototype）。

发表论文: 2014年读博期间，他在《科学》杂志上以第一作者身份发表了题为《宽波段光学的角度选择》的论文，首次实现了在材料尺度上对光的传播方向的选择。

其他荣誉: 2022年4月入选世界经济论坛“全球青年领袖”。



刘峻诚
耐能Kneron
创始人&CEO

学习经历: 获得美国雷神公司奖学金和加州大学奖学金进入美国加州大学伯克利、洛杉矶与圣地亚哥分校的共同研究计划硕博班，并获得加州大学洛杉矶分校电子工程博士学位。

职业经历: 曾在高通、三星电子先进研发中心、晨星半导体（MStar），和Wireless Info等企业担任要职。

国际专利: 在人工智能、计算机视觉和图像处理领域拥有40多个国际专利。



吴强
后摩智能
创始人&CEO

学习经历: 美国普林斯顿大学博士

职业经历: 曾任AMD专家、Facebook资深技术专家、地平线CTO等。2020年11月，成立后摩智能。

发表论文: 曾获MICRO-38唯一一个最佳论文奖，科研成果被IEEE Micro 评选为年度最有影响的12个科技成果之一。

其他荣誉: 顶级芯片学术会议(ISCA等) 组委会委员，美国NSF云计算评审委员会委员。

中国芯片半导体行业教授创业公司



超40个教授加入到芯片半导体的创业浪潮中

芯片半导体公司中的教授创业人才（部分一）

姓名	人物	职位	过往/现任经历	所在公司	公司简介
陈云霁		联合创始人	中国科学院大学岗位教授	寒武纪	深度学习专用的智能芯片
金贤敏		创始人	上海交通大学长聘教授	图灵量子	光量子芯片和光量子计算机
乔宁		创始人兼首席执行官	苏黎世大学助理教授	时识科技	类脑计算及类脑芯片设计与研发商
陈怡然		董事长	杜克大学电子与计算机工程系教授	苹芯科技	AI加速器芯片研发商
朱阳军		董事长	中国科学院大学客座教授	芯长征	新型功率半导体器件研发商

中国芯片半导体行业教授创业公司

超40个教授加入到芯片半导体的创业浪潮中



芯片半导体公司中的教授创业人才（部分二）

姓名	职位	过往/现任经历	所在公司	公司简介
陈兢	创始人	北京大学教授	 含光微纳	微流控与生物芯片的研发和产品制造
James Harris	创始人	斯坦福大学电子教授	 灵明光子	国内单光子传感器芯片研发商
萧启阳	创始人	加州大学尔湾分校(UCI)的特聘助理教授	 云豹智能	云计算和数据中心数据处理器芯片解决方案商
马恺声	创始人	清华大学交叉信息研究院助理教授	 北极雄芯	集成电路芯片研发商
单建安	董事长	香港科技大学电子与计算机工程学系教授	 安建科技	功率半导体元器件
程林	创始人	中国科学技术大学微电子学院教授	乘翎微电子	高性能电源管理芯片研发商
杨五强	首席技术官	英国曼彻斯特大学终身教授	他山科技	人工智能触摸传感器芯片生产商

中国芯片半导体公司总裁、CEO创业公司



超80个总裁、CEO加入到芯片半导体的创业浪潮中

芯片半导体公司中的总裁、CEO创业人才（部分一）

姓名	所在公司	职位	简介	过往经历
陈黎明	地平线	总裁	人工智能解决方案提供商	原博世底盘控制系统中国区总裁
方懿	地平线	硬件副总裁	人工智能解决方案提供商	前诺基亚智能手机大中华区研发副总裁
赵立东	燧原科技	创始人兼CEO	人工智能领域云端算力平台	原紫光集团副总裁
张元基	奕斯伟	董事会副主席	集成电路领域产品和服务提供商	曾担任中国三星CEO
戴保家	翱捷科技ASR	董事长	消费类电子芯片平台型公司	锐迪科前董事长兼CEO
张亮	恒玄科技	董事长	SOC芯片研发商	前RDA总裁
张弛	贝特莱	董事长	数模混合信号集成电路技术解决方案供应商	前北京迈托普公司高级副总裁
单记章	黑芝麻智能	CEO	视觉感知技术与自主IP芯片研发商	前顶尖图像传感器公司OminiVison技术副总裁
黄浴	黑芝麻智能	副总裁	视觉感知技术与自主IP芯片研发商	曾担任奇点汽车美国公司总裁
吴忠洁	灵动微电子	董事长	MCU产品研发与应用解决方案提供商	曾担任无锡华大国奇科技有限公司副总裁
汪凯	华芯通	首席执行官	服务器芯片研发商	曾担任Broadcom 副总裁
田兴银	普莱信智能	创始人	半导体及自动化设备制造商	曾担任清科集团副总裁
陈恂	安谋科技	联席CEO	半导体芯片研发生产商	曾担任摩根大通(JPMorgan)高级副总裁
杨波	伟芯光电	创始人兼CEO	光电子集成芯片研发商	曾在多家科技创新企业担任研发及运营副总裁
楚庆	紫光展锐	CEO	芯片研发与设计	曾担任华为战略与技术副总裁兼海思半导体首席战略官、紫光集团执行副总裁

截止日期：2022年6月30日 数据来源：IT桔子 © itjuzi.com

中国芯片半导体公司总裁、CEO创业公司

超80个总裁、CEO加入到芯片半导体的创业浪潮中



芯片半导体公司中的总裁、CEO创业人才（部分二）

姓名	所在公司	职位	简介	过往经历
任奇伟	紫光展锐	CEO	芯片研发与设计	曾担任西安紫光国芯半导体总裁
吴子宁	英韧科技	CEO	半导体芯片设计公司	曾担任美满电子科技副总裁、CTO
陈俊	宜确半导体	董事长	高性能射频前端集成电路生产商	前RDA分管PA事业部副总裁
张文	壁仞科技	创始人	通用智能计算芯片	曾担任商汤科技总裁
李新荣	壁仞科技	联席CEO	通用智能计算芯片	曾担任AMD全球副总裁
徐滔	赛昉科技	CEO	芯片及RISC-V解决方案供应商	曾任灿芯半导体副总裁、COO和CEO
江朝晖	跃昉科技	CTO	格兰仕旗下芯片设计公司	前谷歌云全球CTO，前思科Cisco全球企业网事业部全球副总裁
张辉	墨芯人工智能	销售副总裁	AI芯片设计商	曾担任某AI独角兽销售副总裁
李孟璋	芯耀辉	CTO	先进半导体IP研发和服务	曾担任紫光展锐ASIC高级副总裁
仇肖莘	爱芯元智	创始人兼CEO	AI视觉芯片研发及基础算力平台	曾担任美国博通公司副总裁
李春潮	鹏瞰科技	创始人	全新半导体解决方案提供商	曾担任Marvell移动产品开发全球副总裁
萧启阳	云豹智能	创始人	云计算和数据中心数据处理器芯片解决方案商	曾担任美国RMI微电子有限公司亚太区总裁
吴日正	诺磊科技	创始人	边缘人工智能芯片研发商	原豪威科技总裁及联合创始人
曹图强	云合智网	创始人	高端网络芯片制造商	原思科集团全球副总裁
潘建岳	承芯半导体	董事长	集成电路芯片及模组关键元件服务商	曾任美国新思科技有限公司亚太区总裁
王冰	篆芯半导体	CEO	半导体设备制造商	曾担任港湾网络副总裁、华三安全产品线总裁、迪普科技CEO
李潇	欧冶半导体	董事长	智能汽车芯片及解决方案供应商	曾担任国投创新投资公司副总裁

2021年至今新增芯片半导体代表公司



2021年至今芯片半导体行业值得关注的新公司

公司简称	成立时间	简介	融资时间	轮次	金额	投资方	核心团队介绍
百度昆仑芯片	2021-3	百度旗下芯片设计和制造商	2021-3	战略投资	数亿元	CPE源峰、IDG资本、君联资本、元禾控股	CEO欧阳剑，现任百度主任架构师、技术总监
苹芯科技	2021-2	AI加速器芯片研发商	2021-2	天使轮	未透露	红杉资本中国、普华资本	创始人兼CEO，曾在美国加州硅谷美光科技科技担任首席系统架构师
寒武纪行歌	2021-1	AI芯片研发商	2021-9	战略投资	未透露	金茂资本、尚颀资本、宁德时代	CEO陈天石，寒武纪科技联合创始人、CEO
篆芯半导体	2021-1	半导体设备制造商	2022-3	天使轮	近亿元	华业天成、高榕资本、利河伯资本	CEO王冰，曾任职于华为企业网络事业部副总监、港湾网络副总裁、华三安全产品线总裁、迪普科技CEO
红西瓜半导体	2021-12	智能芯片研发商	2022-2	天使轮	数千万元	高瓴投资、五源资本	联合创始人余凯，地平线机器人科技创始人、CEO，曾担任百度深度学习研究院IDL常务副院长
傲芯科技	2021-3	集成电路芯片设计及服务	2021-12	天使轮	数百万万元	英诺天使基金、藕航天使	创始人郑飞君，曾在最大电子设计自动化软件公司 Synopsys 任研发工程师。2013-2014年10月同时在加州大学 (UCSB) 电子系任研究科学家
乘翎微电子	2022-1	高性能电源管理芯片研发商	2022-4	天使轮	数千万元	创谷投资、合肥高投、科大讯飞、合肥仁发	创始人程林，中国科学技术大学微电子学院教授

2021年至今国内新晋升为独角兽的企业



共有8家芯片半导体企业晋升为独角兽公司，其中粤芯半导体仅获一轮融资便成独角兽

2021年至今国内新晋升为独角兽的芯片半导体企业

公司	成立时间	简介	上榜时间	历史融资次数	背后知名资方
燧原科技	2018-3	主攻人工智能领域云端算力芯片	2021-1	5	腾讯投资、CPE源峰、真格基金、中金资本
天数智芯	2015-12	通用GPU 云端芯片及超级算力系统提供商	2021-3	5	联通、大钲资本、上海电气香港有限公司
粤芯半导体	2017-12	芯片生产商	2021-7	1	广东半导体及集成电路产业投资基金、华登国际、广汽集团、兰璞创投、农银投资
荣芯半导体	2021-4	半导体分立器件制造商	2021-8	2	红杉资本中国、美团、清控银杏创投、元禾控股
黑芝麻智能	2017-1	视觉感知技术与自主IP芯片研发商	2021-9	5	小米集团、北极光创投、君联资本、博原资本、联想创投、招商局创投、中国汽车芯片产业创新战略联盟、元禾控股、武岳峰资本
盛合晶微	2014-11	芯片研发商	2021-10	3	高通、国家集成电路产业投资基金、中芯国际、华登国际、中金资本、元禾控股、华泰证券、建信资本、碧桂园创投
积塔半导体	2017-11	半导体芯片研发商	2021-11	2	上海集成电路产业投资基金、国改双百基金、CPE源峰、国泰君安、创维集团、中金资本、上海自贸区基金、中国互联网投资基金、深投控、国调基金、小米长江产业基金
瀚博半导体	2018-12	AI视觉芯片研发商	2021-12	3	经纬创投、真格基金、阿里巴巴、快手、五源资本、中国互联网投资基金

截止日期：2022年6月 数据来源：IT桔子 © itjuzi.com



||| PART THREE |||||

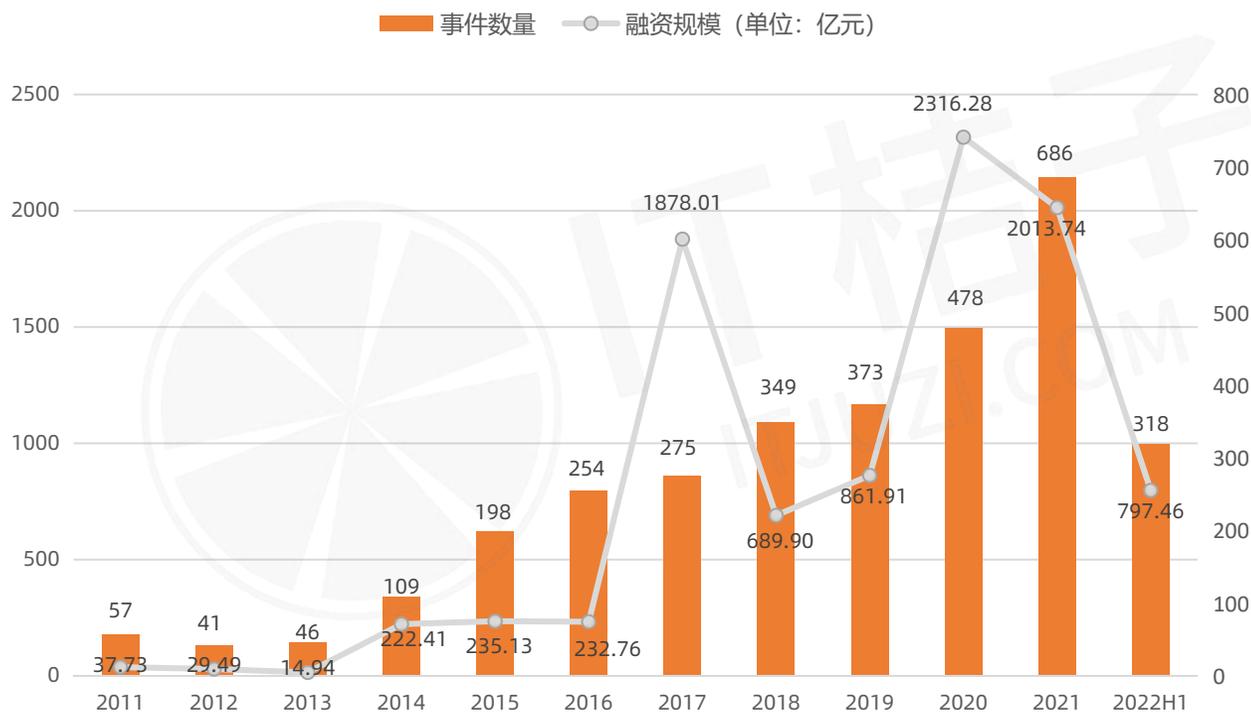
中国芯片半导体行业 投融资情况分析



近十年芯片半导体行业融资事件数量及规模

近十年芯片半导体领域共发生3184起投融资事件，融资总规模达9329.76亿元

中国近十年芯片半导体行业融资事件数量及规模



截止日期：2022年6月21日 数据来源：IT桔子 © itjuzi.com

自2011年以来，中国芯片半导体领域共发生3184起投融资事件，整体呈上升趋势。投融资交易高峰发生在2018-2021年期间，每年均有300+起事件发生。其中在2021年达到顶峰，共有686起投融资事件。芯片半导体投融资交易的上升，与近年来国家对该领域的政策与相关资金大力支持有很大关系。例如，为促进集成电路发展，2014年国家集成电路产业投资基金成立，首期募集资金近1400亿元，用于支持中国芯片半导体公司成长。该基金在此后多年都持续、高频的对芯片产业做投资。

从融资规模来看，近十年芯片半导体领域融资规模达9329.76亿元。尤其是随着美国对中国相关公司的封禁，“缺芯”“芯片荒”等问题的出现，不断上升的芯片半导体需求促使各大投资机构与企业不断投资，至2020年融资已达千亿规模。

中国芯片半导体行业最活跃的投资方TOP 10



*以上数据根据市场已公开信息统计 截止日期：2022年6月21日 数据来源：IT桔子 © itjuzi.com

中国芯片半导体行业最活跃的十大投资方



TOP 1 玩家为元禾控股，出手投资事件为117起；TOP 2 玩家为深创投，出手投资105次



元禾控股凭借在芯片半导体行业出手投资的117起事件，坐上第一的宝座。元禾控股全称“苏州元禾控股股份有限公司”（以下简称“元禾控股”），是由苏州工业园区管委会控股，江苏省国信集团参股的国有投资控股企业，业务涵盖股权投资、债权融资和投融资服务三大板块。其中，股权投资是元禾控股最主要的业务板块，目前管理基金规模超千亿元。

元禾控股一方面投资多个初创公司，支持中小企业的成长，一方面又参与投资行业内多个巨头公司，包括参与投资半导体设计公司巨头韦尔股份，集成电路芯片制造商**纳芯微**等。它所持有的**独角兽公司**包括视觉感知技术与自主IP芯片研发商**黑芝麻智能**、显示控制芯片整体解决方案提供商**集创北方**、百度旗下芯片设计和制造商**百度昆仑芯片**和晶圆代工企业**荣芯半导体**等。

此外，元禾控股旗下汇集多家管理团队专注于不同的投资阶段和领域。例如偏好技术、专注早期投资的**元禾原点**，参与了深度学习智能芯片研发公司寒武纪Pre-A轮、A轮及B轮投资，光量子芯片和光量子计算机公司图灵量子Pre-A轮投资等。

而专注于集成电路产业领域投资的**元禾璞华**——截止到2022年6月21日，IT桔子收录到的数据显示元禾璞华在芯片半导体领域的投资达45次。在此期间元禾璞华投出了多个上市公司，包括消费类电子芯片平台型公司**翱捷科技ASR**、集成电路芯片制造商**纳芯微**和芯片研发商**盛合晶微**等。



深创投凭借105起投资事件数量，成为芯片半导体第二大活跃投资方。IT桔子数据显示，深创投在芯片半导体行业的第一笔投资发生在1997年，当时它参与投资了光纤通信技术服务开发商正有网络，该公司生产ZYIC系列芯片。此后深创投不断在该领域投资。

尤其是2019-2021年期间，深创投出手频繁，3年时间投资事件达57起，占据历史总投资数量的一半。进入到2022年，深创投依旧保持迅猛的投资势头，这半年其在芯片半导体的投资已达15起。

深创投曾参与投资、已上市的公司包括可编程逻辑器件及芯片生产商**安路科技**，SOC芯片研发商**恒玄科技**，集成电路芯片研发商**睿创微纳**等，此外它还持有独角兽公司**比亚迪半导体**等。

深创投董事长倪泽望在2022年的媒体采访中表示：“国家需要什么，深创投就投资什么”。未来，深创投或将继续坚持围绕科技创新的主旋律进行布局。

中国芯片半导体行业最活跃的十大投资方



TOP 3 玩家为中芯聚源，出手投资事件为102起；TOP 4 玩家为“大基金”，出手投资96次



凭借102起投资事件数量，中芯聚源成为芯片半导体领域第三大活跃投资方。

据企查查信息显示，中芯聚源是由中芯国际集成电路制造（上海）有限公司和丰惠控股集团有限公司共同出资成立。在官网的核心团队成员介绍中，中芯国际董事长高永岗为其董事长。

中芯聚源专注于对芯片半导体产业链中的材料、设计、装备、IP和服务等环节的优质企业进行投资，并为被投资企业提供全面的增值服务。

公开数据显示，中芯聚源投资多家芯片公司成功上市，包括无线通讯射频芯片研发商博通集成，半导体设计研发商东芯半导体等。据悉，**中芯聚源投资的芯片设计公司就有12家在A股上市，包括格科微、东微半导体等。**

此外，中芯聚源还在2020年战略投资了通用智能计算芯片**壁仞科技**，如今已成为**独角兽公司**。

根据其介绍，中芯聚源将配合国家集成电路产业基金和各地方政府的专项基金，联合业内的龙头企业和投资伙伴，共同扶持数家有核心竞争力的集成电路企业，加速国内产业的整合和企业质量提升，持续改善国内的集成电路产业生态系统。



为促进集成电路产业发展，2014年由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业发起的国家集成电路产业投资基金(俗称“大基金”)成立。大基金重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，实施市场化运作、专业化管理。

目前，大基金分为一期和二期。**大基金一期总募资金额1387.2亿元**，分为投资期、回收期、延展期各5年，投资计划为期15年。**2015年2月13日，大基金将向紫光集团旗下的芯片业务投资100亿元。这是该基金成立以来进行的首个大规模投资。**

大基金一期投资涵盖集成电路产业链上下游各个环节，其中芯片半导体制造板块投资占比67%，芯片半导体设计板块占比为17%。在此期间大基金一期扶持了一批国内顶尖、国际领先的半导体公司，例如投资的**三安光电**已成长为全球领先的LED芯片制造厂商，填补了我国化合物半导体市场空白；**中芯国际**晶圆代工市占率全球第4等。

2019年10月22日，**大基金二期成立，募资金额2041.5亿元**。相比大基金一期，大基金二期投资领域更加聚焦在短板明显的设备、材料领域。

大基金二期投资的半导体设备公司包括拥有台积电、英特尔等顶级客户的**中微公司**，国内湿法设备的主要供应商之一的**至微半导体**等；投资的半导体材料公司包括**兴福电子**，台积电、华虹集团、中芯国际等一批知名半导体为其客户。

此外，**大基金二期还投资了一批独角兽企业，包括紫光展锐、长鑫存储、中芯南方、艾派克微电子等。**

中国芯片半导体行业最活跃的十大投资方



TOP 5 玩家为小米集团，出手投资事件为90起；TOP 6 玩家为华登国际，出手投资76次



截止到2022年6月21日，小米集团连同小米长江产业基金和顺为资本，在芯片半导体行业的投资达90次。

值得关注的是，小米在该领域的投资时间并不长。IT桔子数据显示，**2016年**小米集团连同海尔和赛富基金，为无晶圆厂半导体公司乐鑫科技送去了数千万元融资，是小米集团在芯片半导体领域的**第一笔投资**。

作为互联网科技公司，小米集团在芯片半导体领域的投资并不意外，旗下手机、智能家居产品等产品均需要大量的芯片半导体供应。更重要的是，自雷军宣布于2021年3月宣布造车以来，小米集团在芯片半导体上的投资更为频繁。

IT桔子数据显示，**仅2021年小米集团在芯片半导体领域的投资多达34起，占历史总投资事件的38%，且有10起事件为战略独投。**

通过梳理过往投资的企业，IT桔子发现小米投出了多家**上市公司**。包括无晶圆厂半导体公司**乐鑫科技**，集成电路芯片制造商**纳芯微**，射频与高端模拟集成电路研发商**唯捷创芯**，SOC芯片研发商**恒玄科技**，平台化芯片设计服务商**芯原微电子**。



于1987年在美国成立的华登国际（Walden International）是全球知名的风险投资机构，自1993年进入中国。截止到2022年6月21日，华登国际在中国市场投资的芯片半导体事件达76起。

华登国际在中国半导体市场投资的时间长达20多年。**最早于1998年就A轮投资了中国半导体设计公司新涛科技，2011年华登国际还成立了第一支中国半导体产业链基金**，到现在为止已经第四期，加上美元基金，总管理规模超30亿美元。

通过梳理华登国际在中国投资的芯片半导体公司数据，IT桔子发现华登国际注重对早期创业公司的投资，**超40%的投资事件为A轮、天使轮投资**。其中华登国际2016年参与投资的Pre-A轮融资公司翱捷科技ASR在2022年成功上市；A轮投资的通用智能计算芯片公司壁仞科技在2020年成为独角兽公司。

作为投资周期较为漫长的集成电路产业，**华登国际极其有耐心做长线投资。从华登投资到科创板上市，格科微花了16年、中微17年、中芯国际21年。**

中国芯片半导体行业最活跃的十大投资方



TOP 7 玩家为中科创星，出手投资事件为71起；TOP 8 玩家为同创伟业，出手投资58次



作为中国首个专注于硬科技创业投资与孵化的专业平台，中科创星（西安）由中科院西安光机所联合社会资本发起创办，致力于打造以“研究机构+天使投资+创业平台+孵化服务”为一体的硬科技创业生态。

中科创星旗下管理西科天使一期、西科天使二期、西科天使三期、大数据孵化基金、大数据产业基金、西安中科成长基金、陕西光电子集成基金、北京硬科技创投基金等数只已经运行的基金。据官网介绍，**截止2022年4月底，中科创星总规模61亿元，已投资孵化364家硬科技企业。**

作为专注于硬科技方向的投资，光电芯片是中科创星投资的重点领域。IT桔子数据显示，截止到2022年6月21日中科创星在芯片半导体领域出手投资71次，涉及56家公司，投资的知名公司包括新型功率半导体器件研发商**芯长征**，光刻机供应链企业**启尔机电**等。

从投资轮次来看，中科创星对初创公司的支持更为明显。IT桔子数据显示，在过往投资的71起事件中，天使轮和A轮投资事件为53次，占比高达**74.6%**。



截止到2022年6月21日，同创伟业已经在芯片半导体行业投资事件达58起。IT桔子数据显示，同创伟业早在2007年便投资了集成电路产品开发商无锡硅动力，这也是同创伟业在该领域的第一笔投资。

随着科技进步、行业发展和政策的倾斜，意识到芯片半导体行业将迎来高速发展期的同创伟业，在2017年对自身投资板块进行分工，将半导体行业作为一个板块进行投资，之后又特别设立半导体主题基金。自此之后，同创伟业在该领域的投资节奏加快，2018-2021年期间投资事件达37起。尤其是2021年，同创伟业出手投资14次，成为历年投资数量之最。

2022上半年，同创伟业在芯片半导体领域的投资已达6起，依旧保持高速的投资节奏。

在投资上，同创伟业有自己的一套理念——首先关注于赛道，其次才关注于公司本身。同创伟业投资的知名公司有位居国内市场第一的射频滤波器芯片研发巨头**汉天下**，半导体器件研发领头公司**韦尔股份**。**数据显示，同创伟业投资的超40家芯片半导体中有十多家已经完成上市。**

未来同创伟业在芯片半导体行业的投资聚焦于上游装备、材料、制造，解决目前“卡脖子”难题的企业。

中国芯片半导体行业背后最活跃的十大投资方



TOP 9 玩家为红杉资本中国，出手投资事件为58起；TOP 10 玩家为达晨财智，出手投资42次

SEQUOIA CAPITAL

红杉资本 | CHINA

根据公开信息，于2006年参与投资的图像传感器芯片设计公司**格科微**，开启了红杉资本中国在芯片半导体领域的投资大门。

尽管红杉资本中国在芯片半导体领域的投资时间较早，但真正开始发力是在2020年。IT桔子收录到的公开数据显示，2020年之前红杉资本中国在芯片半导体领域的投资不过十几起，但在2020-2021年期间分别投出11起、24起事件。到2022年（数据截止至2022年6月21日），红杉资本中国已出手投资8次。甚至在2022年4月，红杉资本中国在一个月的时间内投了3家公司，出手迅速。

红杉中国于2015年种子轮投资的AI 芯片开发商**地平线**，如今已为行业头部企业，并在2017年成为独角兽企业；其投资的晶圆代工企业**荣芯半导体**也在之后成为独角兽企业。

另外，红杉资本中国2006年早期参与投资的A轮集成电路设计企业**卓胜微电子**，之后于2019年于深交所上市。



从2014年投资的一家半导体公司算起，截止到2022年6月21日达晨财智在芯片半导体领域投资的公司共有37家，投资涉及金额达16亿元。

达晨财智投资高峰年份在2020年，这一年达晨财智出手投资8次，投资的企业涉及芯片研发制造和集成电路封装等领域。2022年，达晨财智投资进一步扩大在该领域的投资范围，例如投资氮化镓衬底及芯片研发生产商**吴越半导体**，泛半导体领域智能制造技术供应商**润石科技**。据了解，达晨财智内部成立了专业化的团队和基金，可以快速地对这个赛道的项目进行投资决策。

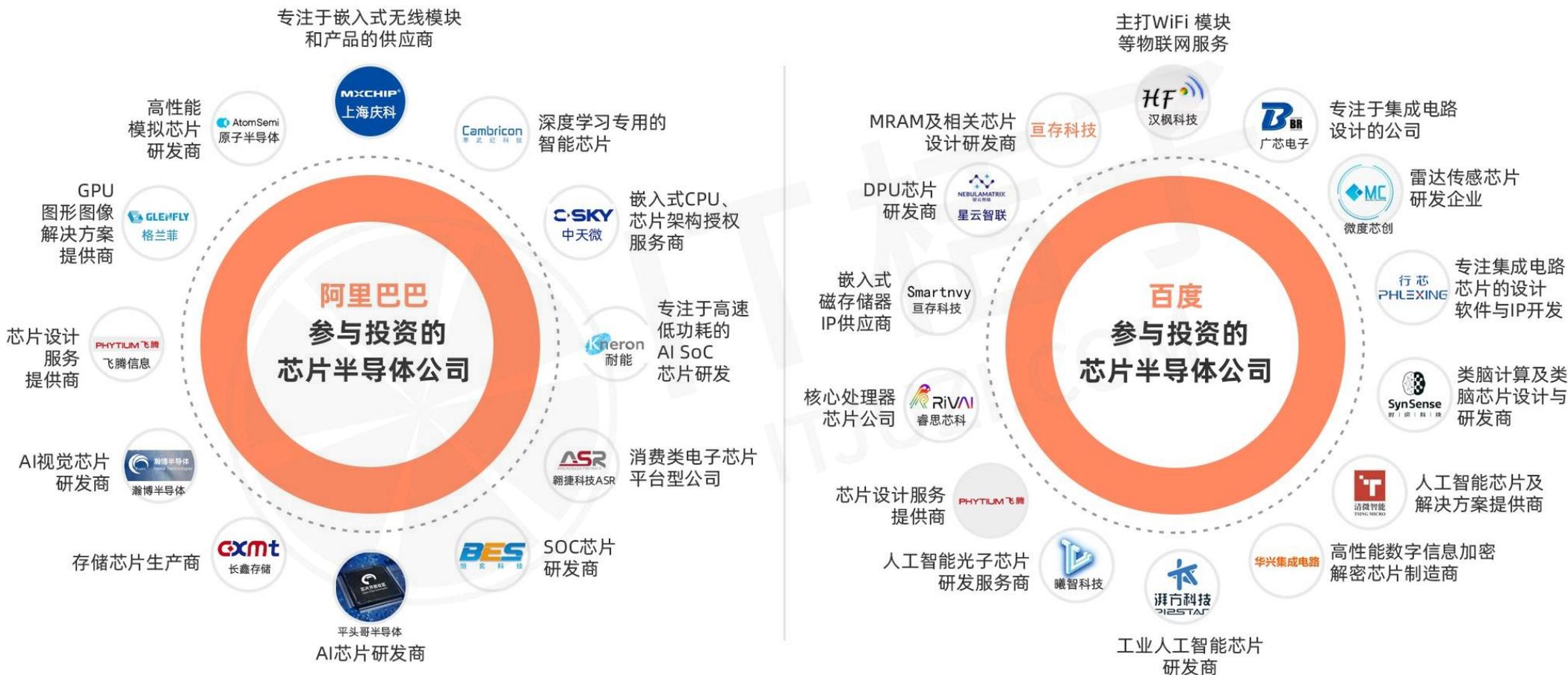
估值和成长性是达晨财智投资半导体项目最基本的逻辑，在此基础上达晨财智投出了7家上市公司，包括集成电路设计研发商**瑞芯微电子**，微波毫米波射频芯片研发商**铖昌科技**等。据悉，2017年达晨财智投资的大功率半导体器件研发公司**新洁能**，赢得了近三十倍的回报。

核心电子器件、高端通用芯片等企业，未来仍是达晨财智投资团队所重点关注的投资领域。

中国互联网巨头在芯片半导体领域的投资布局

阿里巴巴出手投资13次，包括3家上市公司，2家独角兽公司；百度出手投资19次

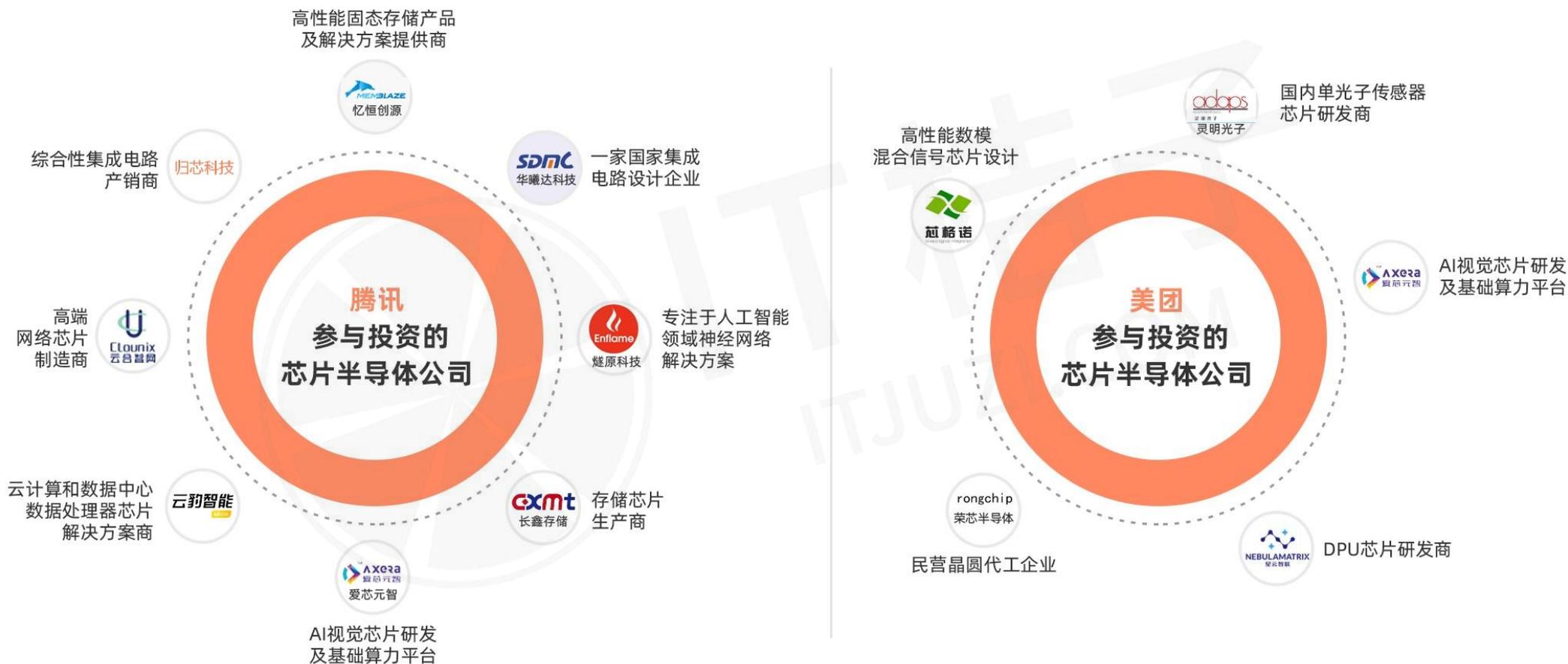
互联网巨头（阿里巴巴、百度）投资的芯片半导体企业



中国互联网巨头在芯片半导体领域的投资布局

腾讯出手投资12次，包括3家独角兽公司；美团出手投资6次，含1家独角兽公司

互联网巨头（腾讯、美团）投资的芯片半导体企业



中国互联网巨头在芯片半导体领域的投资布局

小米出手投资90次，包括4家独角兽公司；华为出手投资36次，含1家上市公司

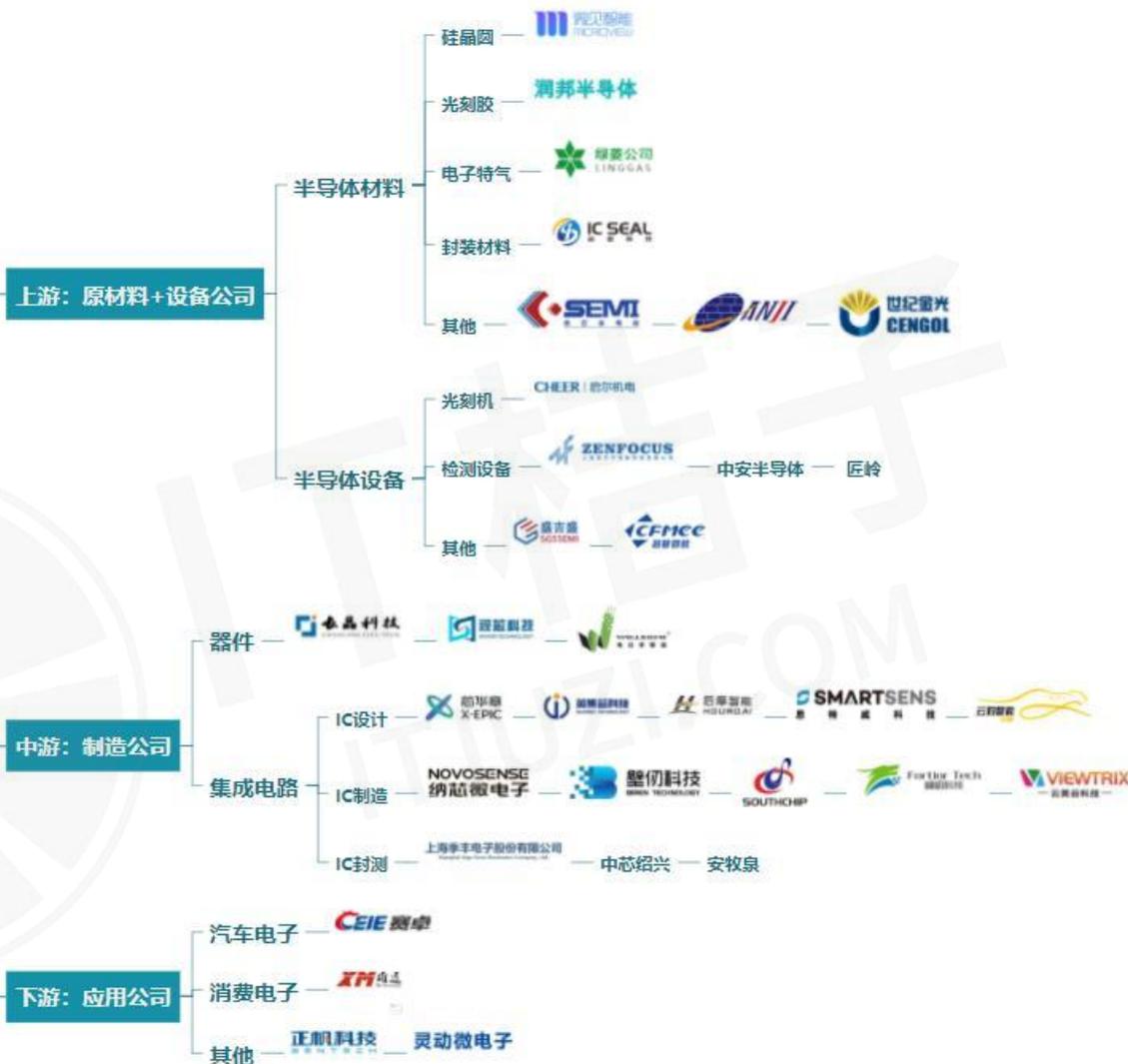
互联网巨头（小米、华为）投资的知名芯片半导体企业



中国芯片半导体行业背后最活跃的企业投资方

中芯聚源出手投资102次，成中国芯片半导体行业背后最活跃的企业投资方

中芯聚源在芯片半导体领域的投资布局



中芯聚源是由中芯国际集成电路制造（上海）有限公司和丰惠控股集团有限公司共同出资成立。在官网的核心团队成员介绍中，中芯国际董事长高永岗为其董事长。

聚源资本专注于集成电路行业的相关领域，对产业链中的材料、设计、装备、IP和服务等环节的优质企业进行投资，并为被投资企业提供全面的增值服务。

中芯聚源投资的企业多集中在芯片半导体的中游公司。IT桔子数据显示，中芯聚源在该方向出手投资达79次。

其中投资的知名集成电路设计公司有心华章、后摩智能、思特威、图灵量子等超20家公司。

投资的知名集成电路制造公司有纳芯微、壁仞科技、南芯半导体、集创北方等超40家公司。

近十年中国芯片半导体行业获巨额融资的事件



2021年至今单笔融资金额超10亿元的事件达69起，融资金额超50亿元的事件有18起

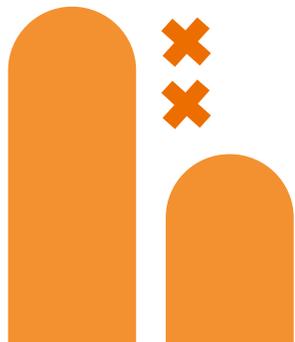
2011年至今单笔融资超50亿元的芯片半导体公司

公司简称	成立时间	省	简介	融资时间	轮次	金额	投资方
紫光集团	1988-1	北京	集成电路芯片设计制造商	2017-03-28	战略投资	1500亿元	国开国际投资、华芯投资
中芯南方	2016-12	上海	集成电路芯片制造、针测及凸块制造	2018-01-31	战略投资	32.9亿美元	国家集成电路产业投资基金、上海集成电路产业投资基金、中芯国际
				2020-05-16	战略投资	22.5亿美元	国家集成电路产业投资基金、上海集成电路产业投资基金
京东方	1993-4	北京	显示设备制造商与显示技术解决方案的提供商	2021-01-18	IPO上市后	200亿元	北京国有资本
长鑫存储	2017-11	安徽	存储芯片生产商	2020-12-16	战略投资	156.5亿元	皖投集团、国家集成电路产业投资基金、招银国际、中国人寿、中国农业银行、建银国际、君联资本、国开装备基金、小米长江产业基金、中金资本、招商证券、招商致远资本、图灵资管、锋盛股权投资、兆易创新、徽商银行
韦尔股份	2007-5	上海	半导体器件研发商	2019-08-28	IPO上市后	135.12亿元	璞华资本、元禾控股、惠友投资、金信通达
地平线	2015-7	北京	人工智能解决方案提供商	2021-06-11	C+轮	15亿美元	未透露
紫光集团	1988-1	北京	集成电路芯片设计制造商	2014-09-01	战略投资	15亿美元	英特尔投资Intel Capital
中微公司	2004-5	上海	微观加工设备研发商	2021-07-05	IPO上市后	82亿元	国家集成电路产业投资基金、GIC新加坡政府投资公司、国泰君安、中金公司 法国巴黎银行、UBS瑞银、瑞华控股、诺德基金、新华保险、广发证券、浦东新产投 时间投资、工银瑞信、高毅资产、南方基金、河南资产、国泰基金
积塔半导体	2017-11	上海	半导体芯片研发商	2021-11-30	战略投资	80亿元	凯辉基金、中电基金、国调基金、中国互联网投资基金、尚颀资本、创维集团、小米长江产业基金、交银国际、上海自贸区基金、浦东科创、浦科投资、浦东科投、CPE源峰、中金资本、国策投资、中保投资、中信建投资本、国泰君安、深投控、国盛集团、国改双百基金、临港新片区科创基金、中航产投、临港集团、汇川技术、华大半导体
三安光电	1993-3	广东	电子元件制造商	2020-06-24	IPO上市后	70亿元	格力电器、长沙先导高芯投资
京东方	1993-4	北京	显示设备制造商与显示技术解决方案的提供商	2018-05-04	IPO上市后	14亿美元	康宁
集创北方	2008-9	北京	显示控制芯片整体解决方案提供商	2021-12-15	E轮	65亿元	海松资本、建信资本、国开装备基金、元禾控股、GGV纪源资本、盛世投资、CPE源峰、芯动能投资、丝路华创、华金投资、景祥资本、中青芯鑫、瑞芯投资、VIVO智能手机
Nexperia	2000-1	广东	半导体元件研发商	2020-03-26	战略投资	63.34亿元	闻泰通讯
三安光电	1993-3	广东	电子元件制造商	2020-04-10	IPO上市后	59.6亿元	长江安芯产业投资基金
北京君正	2005-7	北京	嵌入式CPU芯片及解决方案提供商	2020-05-22	IPO上市后	55.85亿元	上海双创投资中心、武岳峰资本、民和德元、黑龙江万丰投资、联发科软件
华星光电	2009-11	广东	一家专注于显示面板的企业	2020-03-31	战略投资	50亿元	TCL创投
紫光展锐	2013-8	上海	芯片研发与设计	2020-03-17	Pre-IPO	50亿元	国家集成电路产业投资基金、碧桂园创投、上海集成电路产业投资基金、上海科创投资集团(上海科创)



||| PART FOUR ||||

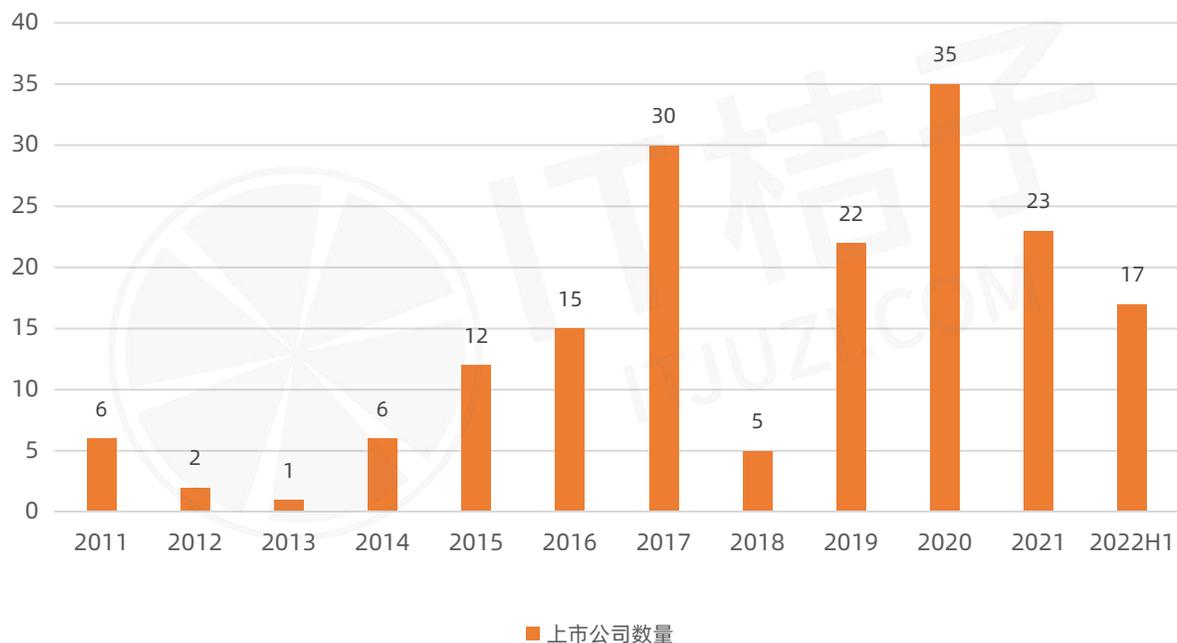
中国芯片半导体公司 上市情况分析



中国芯片半导体公司上市情况分析

近十年已上市芯片半导体公司达174家，其中2020年上市公司数量最多达35家

近十年中国历年芯片半导体上市公司数量



截止日期：2022年6月28日 数据来源：IT桔子 © itjuzi.com

得益于时代的快速发展，芯片半导体作为无数个智能产品背后不可或缺的产业链一环，近年来在芯片短缺危机中，从幕后转到台前，变为市场上众人争论的「主角」。

越发瞩目的芯片半导体企业，在大众的关注中迎来了不间断的高光时刻。

成长起来的公司完成了由一级市场到二级市场的跨域。IT桔子数据显示，截止到2022年6月28日，已上市的中国芯片半导体企业超200家。尤其是自2019年以来，芯片半导体企业迎来上市密集期。2019-2021年期间，敲钟上市的公司数量达80家，仅2020年就有35家芯片半导体企业顺利上市，创造了历年上市公司数量的最高纪录。进入到2022年，芯片半导体公司上市依旧活跃，截止到6月28日，共有17家企业顺利上市。

2021年中国芯片半导体行业上市情况



2021年共有23家芯片半导体公司上市

2021年上市的中国芯片半导体企业

公司名称	成立时间	简介	上市时间	交易所	IPO募资额	上市首日市值
生益电子	1985-08	多层印制电路板制造商	2021-02-25	上交所	20.66亿元	178.34亿元
美迪凯	2010-08	光学精密元器件研发生产商	2021-03-02	上交所	10.22亿元	104.15亿元
美佳音控股	2010-09	兼容打印机耗材芯片供应商	2021-03-31	港交所	1.014亿港元	6.7亿港元
芯碁微装	2015-06	半导体设备研发商	2021-04-01	上交所	4.6亿元	80.92亿元
商络电子	1999-8	电子元器件本土领军分销商	2021-04-21	深交所	2.76亿元	126.5亿元
迅捷兴	2005-08	印制电路板研发生产商	2021-05-11	上交所	2.53亿元	30亿元
气派科技	2006-11	集成电路封装测试技术研发商	2021-06-23	上交所	3.94亿元	65.46亿元
力芯微电子	2002-05	集成电路开发商	2021-06-28	上交所	5.84亿元	99.84亿
复旦微电子	1998-07	集成电路设计开发和解决方案提供商	2021-08-04	上交所	7.48亿元	455.31亿元
本川智能	2006-08	线路板提供商	2021-08-05	深交所	6.21亿元	53亿元
中富电路	2004-03	线路板生产商	2021-08-12	深交所	3.69亿元	53.97亿元
艾为电子	2008-06	混合信号和射频芯片研发商	2021-08-16	上交所	32.01亿元	432.93亿元
格科微	2003-12	图像传感器芯片设计公司	2021-08-18	上交所	23.68亿元	880.86亿元
普冉半导体	2016-01	无自有晶圆厂半导体研发商	2021-08-23	上交所	13.48亿元	175.75亿元
雷电微力	2007-09	微波及射频SOC集成电路设计	2021-08-24	深交所	14.67亿元	273.1亿元
宏微科技	2006-08	电力电子元器件研发商	2021-09-01	上交所	6.77亿元	75.74亿元
安路科技	2011-11	可编程逻辑器件及芯片生产商	2021-11-12	上交所	13.03亿元	281亿元
炬芯科技	2014-06	系统级芯片设计服务提供商	2021-11-29	上交所	13.1亿元	101.26亿元
上海芯导电子	2009-11	模拟集成电路及功率器件提供商	2021-12-01	上交所	20.22亿元	113亿元
东芯半导体	2014-11	半导体设计研发商	2021-12-10	上交所	33.37亿元	206.75亿元
炬光科技	2007-09	半导体激光器研发商	2021-12-24	上交所	17.7亿元	173.53亿元
概伦电子	2010-03	集成电路设计解决方案提供商	2021-12-28	上交所	12.27亿元	185.28亿元

2022年上半年中国芯片半导体行业上市情况



2022年上半年共有17家芯片半导体公司上市

2022年上半年上市的中国芯片半导体企业

公司名称	成立时间	简介	上市时间	交易所	IPO募资额	上市首日市值
国芯科技	2001-06	嵌入式CPU及SoC芯片研发生产商	2022-01-06	上交所	25.19亿元	112亿元
创耀科技	2006-08	通信芯片研发商	2022-01-12	上交所	13.32亿元	70.52亿元
天岳先进	2010-11	第三代半导体碳化硅材料研发生产商	2022-01-12	上交所	35.58亿元	367.4亿元
翱捷科技ASR	2015-04	消费类电子芯片平台型公司	2022-01-14	上交所	68.83亿元	455.95亿元
希荻微	2012-09	电源管理芯片制造商	2022-01-21	上交所	13.43亿元	176.20亿元
东微半导体	2008-09	高性能功率半导体研发商	2022-02-10	上交所	21.89亿元	87.66亿元
长光华芯	2012-03	高功率半导体激光器研发商	2022-04-01	上交所	27.4亿元	107.94亿元
唯捷创芯	2010-06	射频与高端模拟集成电路研发商	2022-04-12	上交所	26.7亿元	170.43亿元
英集芯	2014-11	数模混合集成电路芯片研发设计商	2022-04-19	上交所	10.17亿元	91.90亿元
峰昭科技Fortior	2010-05	电机控制器和驱动器生产商	2022-04-20	上交所	18.86亿元	61.14亿元
拓荆科技	2010-04	高端半导体专用设备服务商	2022-04-20	上交所	22.73亿元,	116.74亿元
纳芯微	2013-05	集成电路芯片制造商	2022-04-22	上交所	58.12亿元	262.34亿
赛微微电	2009-11	电源和电池管理芯片晶圆厂半导体公司	2022-04-22	上交所	14.91亿元	44.10亿元
SmartSens思特威	2017-04	图像传感器芯片设计公司	2022-05-20	上交所	12.6亿元	226.65亿
铖昌科技	2010-11	微波毫米波射频芯片研发商	2022-06-06	深交所	6.06亿元	34.91亿元
华海清科	2013-04	CMP设备和工艺及配套耗材服务商	2022-06-08	上交所	36.45亿元	239.04亿元

截止日期：2022年6月21日 数据来源：IT桔子 © itjuzi.com

中国市值最高的芯片半导体公司TOP 10



截止到2022年6月29日，中国市值最高的公司为台积电，市值高达4374亿美元

中国市值最高的芯片半导体公司TOP 10

排名	公司	成立日期	简介	地区	上市时间	交易所	最新市值
1	台积电	1987-02	集成电路制造服务模式提供商	台湾	1997-10-08	纽交所	4374亿美元
2	隆基绿能科技	2000-02	单晶硅生产制造企业	陕西	2012-04-11	上交所	4862亿元
3	中芯国际	2000-12	集成电路晶圆代工企业	上海	2004-03-18	港交所	3572亿元
4	联发科	1997-05	晶圆厂半导体公司	台湾	2001-07-23	台交所	10503亿新台币（折合人民币2365亿元）
5	TCL中环	1998-12	半导体节能产业和新能源产业公司	天津	2007-04-20	深交所	1730亿元
6	京东方	1993-04	半导体显示产品企业	北京	2001-01-12	深交所	1507亿元
7	韦尔股份	2007-05	半导体器件研发商	上海	2017-05-04	上交所	1473亿元
8	北方华创	2007-10	集成电路高端工艺装备公司	北京	2010-03-16	深交所	1440亿元
9	大全能源	2011-02	晶硅研发制造企业	新疆	2021-07-22	上交所	1244亿元
10	紫光国微	2001-09	集成电路芯片设计开发公司	北京	2005-06-06	深交所	1146亿元

截止日期：2022年6月29日 数据来源：IT桔子 © itjuzi.com

中国市值最高的芯片半导体公司之“最”



最赚钱公司

成立于 1987 年的台积电，能从各大国际巨头中突围成功，初期靠的是代工厂制造业务。作为全球第一家晶圆代工企业，台积电通过晶圆厂生产制造，帮助芯片半导体公司完成中间生产制造一环，与各大巨头之间不存在竞争，反而是合作关系，因此在芯片不断旺盛的市场需求中逐渐建立了自己的地位。如今台积电已成为全球最大的晶圆代工厂，合作的客户包括苹果、高通、索尼等。

之后，逐渐壮大起来的台积电一方面不断吸引人才，加强自身技术建设；另一方面通过投资巩固市场地位。据悉，台积电持有 3D 堆叠晶圆级封装技术公司精材科技 41.01% 的股份，专用集成电路公司创意电子持股 34.84% 等。根据台积电发布的 2022 年第一季度财报，该公司第一季度营收 4910.76 亿新台币（折合人民币 1105.9 亿元），净利润 2028.73 亿新台币（折合人民币 456.87 亿元），成为市值前 10 芯片公司中最赚钱的公司。

2022 年 6 月台积电总裁魏哲家透露，台积电去年启动新建七个厂，今年则要在全球盖五座新厂，进一步扩大自己的产能。



获融资次数最多的公司

韦尔股份是中国半导体设计公司，成立于 2007 年 5 月，于 2017 年在上交所上市，截止到 2022 年 6 月 29 日以 1526 亿元的市值位列中国芯片半导体公司最高市值榜第 7 名。

韦尔股份主要从事半导体设计和销售业务，形成了图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大核心业务体系。2019 年韦尔股份收购数字图像处理方案提供商豪威科技，其生产的系列 CMOS 图像传感芯片广泛应用于消费和工业领域，自此之后韦尔股份成为仅次于索尼、三星的全球第三大传感器解决方案商。

从融资历史来看，IT 桔子数据显示，除去上市募集融资之外，自成立以来韦尔股份获得 5 轮融资，是这十家公司中获得融资次数最多的公司。早在 2011 年，同创伟业联合富汇合创为韦尔股份投资了 3000 万元，成为其最早期的投资人。之后，韦尔股份又相继获得中芯聚源、常春藤资本、清芯华创等机构的投资，背后聚集的资本多达近 20 家。

在登陆上交所之后，韦尔股份又瞄准了下一个上市地。2022 年 6 月 29 日韦尔股份发公告称，为拓宽公司国际融资渠道，满足国际业务发展需要，以及进一步加强全球品牌影响力，公司拟境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市。



上市创最多纪录的公司

2000年成立的中芯国际是集成电路晶圆代工企业，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业。以3643亿元的市值荣登中国芯片半导体公司最高市值公司的第3名。

中芯国际在上海、北京、天津、深圳建有三座8吋晶圆厂和三座12吋晶圆厂；在上海、北京、深圳各有一座12吋晶圆厂在建中。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务。

2020年7月16日，中芯国际登陆上交所科创板，此次上市刷新了当时的众多记录，成为此次十大公司中上市创造最多纪录的公司。

- 最快上市。中芯国际从受理到过会，仅用时19天，被称为「闪电过会」；从申请到正式上市仅用时46天，刷新A股最快上市纪录。
- A股近十年来最大规模IPO。中芯国际于上交所上市首日，开盘价95元/股，较发行价上涨245.96%，共募集资金总额最多达532亿元，即使不行使超额配售选择权，其至少募资463亿元，为A股近十年来最大规模的IPO。
- 荣获多个「市值王」。截止2020年7月16日当日收盘，中芯国际以5917.52亿元的市值成为科创板市值王、芯片股市值王、半导体行业市值王，当时还超过宁德时代、立讯精密等A股科技龙头市值，成为A股科技总龙头。

中芯国际在科创板的这次，并非其第一次上市。此前成立四年后，中芯国际就于2004年分别于3月17日、18日在美国纽约证券交易所和香港联合交易所上市。但之后由于成交低迷和成本太高，中芯国际于2019年5月从纽交所退市。这次成功登陆科创板，中芯国际也成为首家同时实现「A+H」上市的红筹企业。

中国市值最高的芯片半导体公司之“最”



最“年轻”公司

晶硅研发制造企业大全能源以 1244 亿元的市值排在中国市值最高的芯片半导体公司第 9 名。成立于 2011 年的大全能源，于 2021 年 7 月 22 日成功登陆上交所科创板，成为新疆首家科创板上市企业。也是这十所公司中最「年轻」的公司。

大全能源上市发行的 3 亿股中，初始战略配售发行共计 9000 万股，占发行总数的 30%。参与战略配售的机构明星云集，除了大全能源的专项管理计划（高管和员工参与）及保荐机构中金公司跟投外，还包括深创投新材料基金、全国社会保障基金理事会、中保投基金、中国人寿等多家大型知名机构。机构积极参与，与其业务有关。大全能源专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售，是极为重要的优良半导体材料。目前已形成年产 10.5 万吨高纯多晶硅产能，产能规模在业内处于第一梯队。2021 年随着多晶硅价格的持续走高，大全能源业绩暴涨。

根据大全新能源公布的财报数据，2021 年公司营业收入为 16.79 亿美元，同比上涨 148.49%；归属于母公司普通股股东净利润为 7.49 亿美元，同比增长 479.68%。2022 年，大全能源业绩依旧「漂亮」——2022 财年第一季度归属于母公司普通股股东净利润为 5.36 亿美元，同比增长 543.9%；营业收入为 12.80 亿美元，同比上涨 399.94%。



对外投资最多的台湾公司

成立于 1997 年的台湾公司联发科，于 2001 年在台交所上市，如今以市值 10503 亿新台币（折合人民币 2365.2756 亿元）排在第四名的位置。

联发科技的核心业务包括移动通信、智能家居与车用电子领域，着重于研发适用于跨平台的芯片组核心技术，如今已成为全球第四大无晶圆半导体公司。根据其官网介绍，联发科在移动通信芯片领域位居世界第二。在中国市值最高的十大公司中，联发科是对外投资最多的公司。

IT 桔子根据公开信息披露，收录到的数据显示，联发科对外投资的公司超 20 家，投资的公司包括专注深度学习处理器解决方案的人工智能科技公司深鉴科技、半导体设计公司奕力科技、半导体封测公司中华精测等。其中，联发科在 2011 年花费 409 万美元投资的半导体软硬件解决方案商汇顶科技，创造了投资回报的神话。据悉，汇顶科技在 2016 年成功上市后为联发科创下 5 年大赚 600 倍的投资传奇史。

据了解，早在 2014 年联发科便设立了 3 亿美元的风险投资基金，进行多方布局。不仅如此，联发科还联合中国湖北长江蔚新能源产业发展基金会、上海物联网二期创业投资基金等多家基金，投资智能家居、人工智能等领域。

版权声明：

本报告期内所有图表、文字以及融资数据资料，版权均属于北京岁月桔子科技有限公司所有，任何媒体、网站或个人未经本单位协议授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发布、发表。已经本单位协议授权的媒体、网站、在下载使用时必须注明“来源：IT桔子”，违者本单位将依法追究。本报告不构成任何投资建议。

出品方：IT桔子

IT桔子是关注新经济行业的创业投资数据库和商业信息服务提供商，致力于通过信息和数据的生产、聚合、挖掘、加工、处理，帮助目标用户和客户节约时间和金钱、提高效率，以辅助其各类商业行为，包括风险投资、收购、竞争情报、数据定制、行业分析等。

关注 IT 桔子公众号

